

전전기 서보 자동 핫 프레스 1톤 정밀 힘 페루프 제어 150X150 Mm 가열판 무유 청정실 호환

품목 번호: XP84



소개

±1 kg 페루프 제어로 1톤의 힘을 전달하는 고정밀 전전기 서보 자동 핫 프레스입니다. 최대 300°C까지 가열되는 150x150mm 가열판, 프로그래밍 가능한 온도 및 압력 램핑 기능을 갖추고 있으며, 청정실 환경, 반도체, 마이크로플루יד스 및 고분자 필름 연구에 이상적인 100% 무유 방식으로 작동합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
플렉서블 및 인쇄 전자재	고분자 기관상의 플렉서블 디스플레이, 유기 광전지 및 센서 어레이 라미네이션.	무유 및 균일한 압력은 결함을 방지하고 수율이 높은 롤투시트 공정을 보장합니다.
반도체 다이 본딩	마이크로칩 및 MEMS 장치용 청정실 호환 다이 부착 및 공정 본딩.	±1 kg 힘 정확도는 다이 파손을 방지하고 일관된 본드 라인 두께를 보장합니다.
고분자 마이크로 몰딩	열가소성 및 열경화성 필름에 마이크로플루יד 채널 및 광학 요소 핫 엠보싱.	프로그래밍 가능한 온도/압력 램프는 나노 구조를 높은 충실도로 복제합니다.
바이오의료 기기 조립	진단용 생체 적합성 필름, 막 및 마이크로플루יד 카트리지 라미네이션 및 접합.	무오염 작동은 의료 기기용 ISO Class 5 청정실 표준을 충족합니다.
배터리 연구	리튬이온 및 차세대 배터리용 고체 전해질 압축, 전극 라미네이션 및 스택 조립.	정밀한 힘과 온도 제어는 얇은 포일을 손상시키지 않으면서 계면 접촉을 최적화합니다.
복합 재료 경화	항공우주 테스트용 탄소섬유 프리프레그, 접착 필름 및 적층 복합재의 열 및 압력 경화.	균일한 열 분포와 안정적인 힘은 바리 및 보이드 형성을 방지합니다.
박막 고분자 가공	분광학 및 재료 테스트용 균일한 박막으로의 고분자 펠렛 용융 및 프레스.	프로그래밍 가능한 램프는 목표 두께를 달성하면서 열적 열화를 방지합니다.
MEMS 및 나노 기술	나노임프린트 리소그래피 템플릿 및 마이크로 스케일 피쳐 핫 엠보싱.	높은 평행도와 힘 정확도는 서브 마이크로 피쳐 복제를 가능하게 합니다.
접착제 접합 및 바리 시험	패키징 및 조립의 품질 관리를 위한 접합 공정 시뮬레이션 및 바리 강도 측정.	양방향 로드셀은 단일 플랫폼에서 압축 및 인장 프로토콜을 모두 가능하게 합니다.

매개변수	사양	비고
모델	XP84	이 전전기 서보 핫 프레스 구성에 대한 현장별 식별자.
구동 방식	전전기 정밀 서보 모터	100% 무유, 초저소음 작동; 반응성 있는 서보 드라이브와 볼 스크류로 유압 펌프 및 실린더를 대체합니다.
힘 범위	0 - 1톤 (0 - 10 kN)	0에서 최대값까지 연속 조정; 섬세한 저력 응용 분야에 이상적입니다.
힘 정확도	±1 kg (약 ±10 N)	페루프 로드셀 피드백, 열팽창, 재료 크리프 및 이완을 자동 보상합니다.
가열판 크기	150×150 mm (5.9×5.9 인치)	높은 평행도와 평행도로 표면 마감 완료; 선택적 코팅 및 사용자 정의 형상 제공.
최대 개구	50 mm	두꺼운 공구나 다층 스택 적재 가능; 박막 프레스를 위한 완전 폐쇄(0 mm) 가능.
온도 범위	실온 ~ 300°C	각 가열판은 ±1°C 안정성을 갖는 PID로 독립 제어; 0.1 ~ 20°C/min의 프로그래밍 가능한 램프 속도.
제어 소프트웨어	7인치 PID 터치스크린 인터페이스	그래픽 온도/힘 프로필을 통한 직관적인 레시피 생성; 최대 20개 프로그램 저장; 실시간 데이터 표시.

매개변수	사양	비고
가열 전력	1500 W (1.5 kW)	15분 이내에 300°C로 급속 가열; 오버슈트 없는 정밀 램핑을 위해 전력 조절.
냉각 방식	가열판 내 통합 순환 수냉 채널	급속 냉각(예: 쿨러 사용 시 300°C에서 50°C까지 약 10분); 공구 보호 및 생산량 증대.
전원 공급	AC 220V, 50Hz/60Hz, 단상	표준 실험실 콘센트; 내부 퓨즈 및 전압 변동 보호 장비 내장.
인증	CE 안전 인증	운영자 보호를 위한 비상 정지, 과부하 보호 및 안전 인터락 포함.